



tesa HAF® 8410

製品案内 情報



高温熱活性フィルム 60µm厚/茶

製品の説明

tesa® HAF 8410は、ニトリルゴムとフェノール樹脂を主成分とした高温熱活性フィルムです。化学反応（架橋反応）が起きてポリマー同士が繋がるため、強力に接合することができます。硬化反応は不可逆的な変化のため、再加熱してもフィルムが軟化することはありません。

硬化後は高温・高湿などの環境負荷に対し、非常に優れた性能を発揮します。また、油やアルコール等の薬品にも優れた耐性を示します（耐薬品性）。

特徴

- 熱硬化性樹脂の架橋反応により、強力に接合します。
- 常温ではタック（べたつき）がないフィルム状です。
- 金属、ガラス、プラスチック、木材、紙、布等の様々な素材の被着体に対し、非常に高い接着性能を示します。
- 異種材料の接合に好適です。
- 耐熱性、耐老化性、耐薬品性に優れます。
- ゴム成分を含有し長期間柔軟性と応力性を保持します。

用途例

- 各種デバイス部品の永久固定、アセンブリ
- 金属と樹脂など異種材料の接合
- ICカードのチップ固定

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

・ 基材	無し	・ 総厚	60 µm
・ 粘着剤	ニトリルゴム・フェノール樹脂混合物	・ 色	琥珀色
・ ライナー	グラシン		

特性 / 性能

・ 接着力（プッシュアウト）	12 N/mm ²	・ 接着力（動的剪断）	12 N/mm ²
----------------	----------------------	-------------	----------------------

備考

技術的な推奨値（スマートカードの場合）

作業の開始にあたり、装置の設定条件として下記数値を推奨いたします。装置の形式、特にカード本体及びチップモジュールの材質により最適な条件が左右しますので、予めご留意下さい。

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=08410>



tesa HAF® 8410

製品案内 情報

備考

仮接着条件：

仮接着工程は、HAFをモジュールベルト上に貼りつける工程です。この工程は、インライン、オフラインのどちらでもおこなうことが可能です。

温度：130-150°C、圧力：4-6bar、時間：1.5-3.0秒

モジュールの接着：

モジュールの装着工程では、仮接着されたモジュールをモジュールベルトから打ち抜き、カードの溝にはめ込み、さらに熱を加えてカード本体に永久接着させます。この工程では、厳密には装着ラインの型式などで取り扱いが異なりますが、条件が大きく変わることはありません。

1回の加熱工程の場合：

低温硬化=温度：160-180°C、圧力：15-35bar、時間：2.0-4.0秒

高温硬化=温度：180-200°C、圧力：15-35bar、時間：1.0-1.5秒

2回以上の加熱工程の場合：

温度（加熱治具の内部温度を測定）：170-200°C、

圧力：15-35bar、時間（各ステップ毎）：0.7-1.2秒



tesa HAF® 8410

製品案内 情報

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=08410>